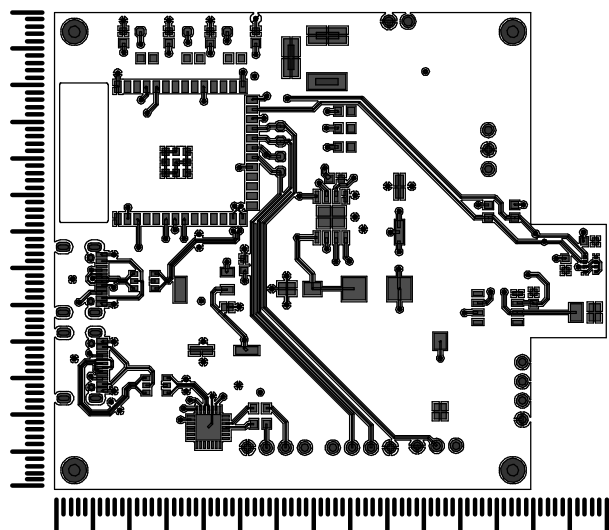


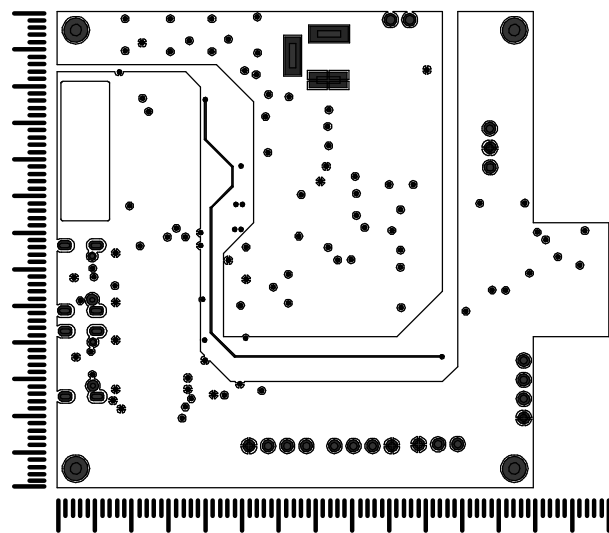
Проводящий рисунок верхней

стороны ПП

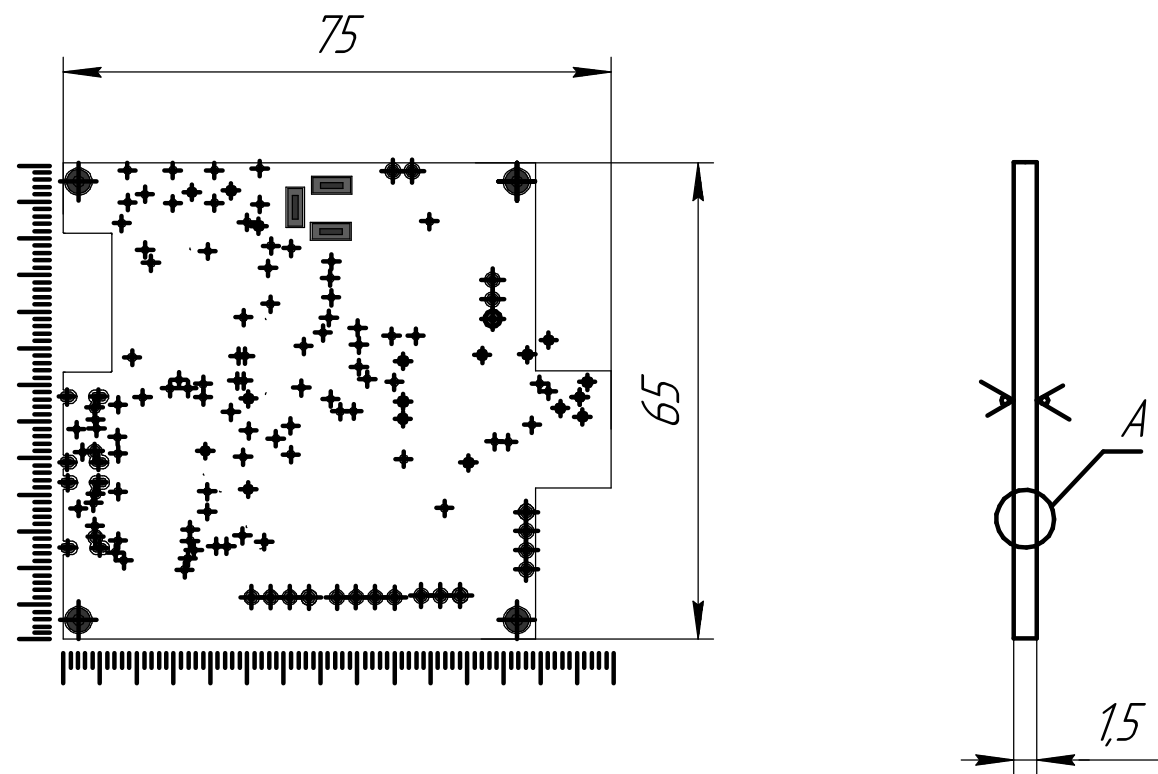


Проводящий рисунок второго

слоя ПП

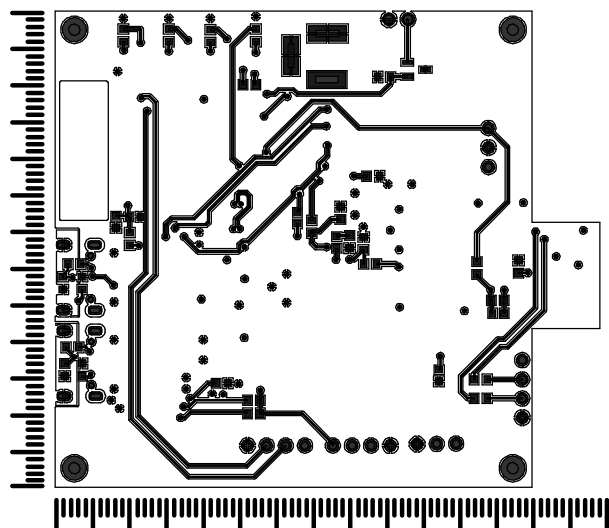


Чертеж отверстий ПП



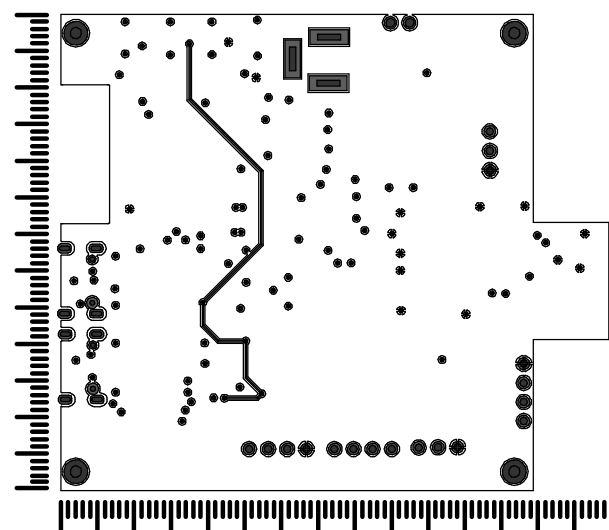
Проводящий рисунок нижней

стороны ПП



Проводящий рисунок третьего

слоя ПП



A (10:1)

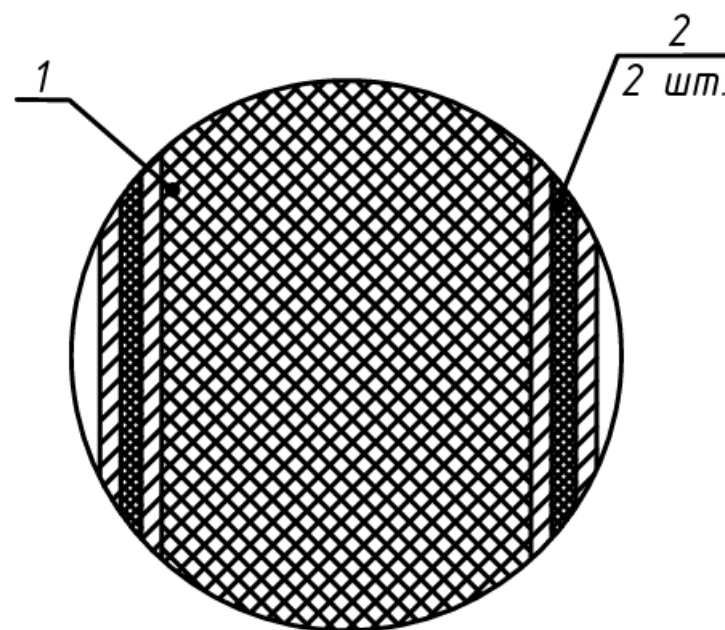


Таблица 1 – Данные отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Диаметр контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
✦	0,3	0,6	да	105
✧	0,8	1,6	да	5
⊕	1,0	2,0	да	26
⊙	3,0		нет	4

- Плату изготавливать методом металлизации сквозных отверстий.
- Для изготовления платы использовать FR4 (Tg150) согласно стандарту IPC-4101/99.
- Покрывтие – иммерсионное золото толщиной 2 мкм.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жёсткости 1.
Класс точности – 4 по ГОСТ Р 53429 – 2009:
 - минимальная номинальная ширина проводника – 0,2 мм;
 - минимальное номинальное расстояние между элементами проводящего рисунка – 0,2 мм;
 - минимальный номинальный диаметр монтажного отверстия – 1,0 мм;
 - минимальный гарантийный поясок контактной площадки – 0,15 мм.

- Параметры отверстий платы представлены в таблице 1.
- Неуказанные предельные отклонения размеров между осями любых отверстий – по ГОСТ Р 53429-2009.
- Точность расположения элементов проводящего рисунка и отверстий обеспечиваются технологическим оборудованием.
- Верхнюю и нижнюю часть платы закрыть защитной маской XV 501 T-4 LV Glass. Цвет маски – чёрный.
- Маркировку выполнять краской ТПНФ-84 белой. У1 ТУ 29-03-089-88.
- Остальные технические требования – по ОСТ4 ГО.070.014-75.

ИУ6.09.04.01.25.04.4101.002 СБ ПП					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Программно-аппаратная система контроля микроклимата
Разраб.	Федотов А.А.				
Проб.	Фетисов М.В.				
Т.контр.					Сборочный печатной платы
Н.контр.					
Утв.					
			Лист	Листов	1
			МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ6 Группа ИУ6-41М		
			Формат А2		